



經濟部

Ministry of Economic Affairs

經濟及產業發展諮詢會 115年第1次會議

【商業及中小企業分組】

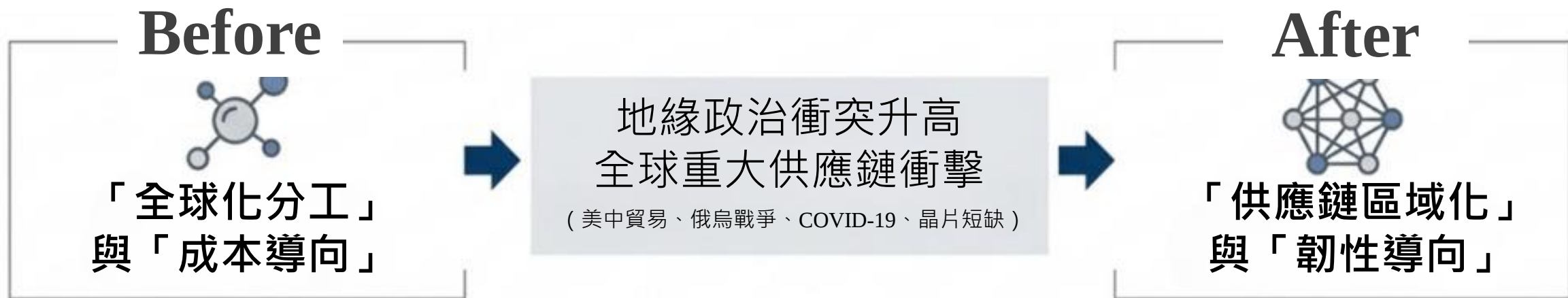
工作分組議題研析報告

報告主題：產業聯盟海外布局機制

主辦單位：中小及新創企業署

會議日期：115年6月12日

一、議題規劃：緣起



供應鏈布局從企業決策，升級為「國家戰略」

核心目標

以產業聯盟作為落實總統
「生態系概念」之
關鍵載體

以大帶小

引導半導體、車用零組件、資通訊
等高科技大廠，帶動傳統產業中小
微企業成為「垂直供應鏈」夥伴

在地聚落

政策資源鎖定「產業園區/工
業區」聚落單位，促進上下
游協同移動與升級

一、議題規劃：面臨課題

中小企業海外布局面臨之挑戰



資源與營運能力不足

- 海外投資與營運成本負擔較重
- 國際營運與管理能力不足



供應鏈重組與產業協同困難

- 產業鏈群聚溝通不足影響效率
- 難以單獨推動海外供應鏈布局



國際政策與市場風險提高

- 關稅與貿易政策變動
- 海外制度環境與營運風險
- 紅色供應鏈與中國產品低價傾銷

一、議題規劃—願景與目標

解決困境

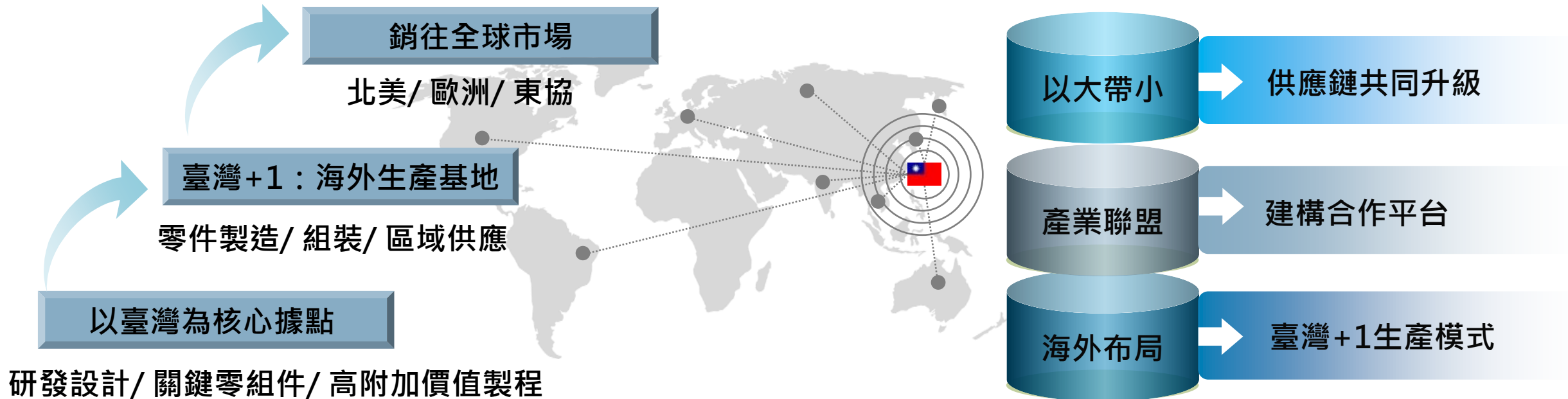
- 中小企業占比逾98%，全球供應鏈重構下，單打獨鬥風險增加，需透過**組織化機制**整合資源與分工協作
- 將由單一企業決策，逐步轉向**產業聯盟與政府政策協同**推動，降低中小企業海外發展門檻與風險

價值

- 強化出口競爭能力
- 提升國際應變韌性
- 擴大全球市場布局

願景

- 整合臺廠海內外生產基地，於重點區位形塑**臺灣+1**；因應美中供應鏈分流，強化在「**非紅供應鏈**」的關鍵地位。
- 透過「**立足臺灣，布局全球，行銷全世界**」，使臺灣成為「**經濟日不落國**」



二、產業聯盟作法

法規認證差異與測試負擔

(各國標準規範不一、認證成本高昂且設備缺乏相容性)

1. **通路布局支援**：串接貿易署補助資源，海外測試中心納入行銷補助範疇
2. **認證成本分攤**：透過SBIR研發聯盟機制協助抵減認證費用

關稅應對與資金營運挑戰

(海外關稅墊付壓力大、缺乏國際通路布局與購併資本)

1. **平台籌組引導**：協助產業聯盟建立海外控股公司或營運平台
2. **國際資訊與諮詢**：建立國際市場資訊平台，並提供聯盟業者客製化之國際法規諮詢服務。

資源精準投遞與轉型引導

(聯盟缺乏分眾定位、轉型資源分散與智慧化升級困難)

1. **政策資源分眾導引**：盤點政策工具並依產業性質對接，確保聯盟精準應用資源
2. **聯盟領軍拓展市場**：推動共同接單與整體解決方案，由指標企業領軍提升海外市場能見度

運用**海外布局四大機制**，擴大聯盟規模，並整合技術、市場及法規等資源，協助中小企業進入國際供應鏈體系

持續擴大產業聯盟規模

- 導入具產業指標性之領導廠商擔任核心成員，發揮示範與帶動效應
- 將具發展潛力之新創及中小企業納入聯盟

建立整合性服務機制

- 針對重點國家進行市場情資蒐研，協助企業掌握市場布局策略
- 提供聯盟客製化輔導，加速產業切入國際市場

深化海外市場鏈結

- 組織聯盟成員參與國際專業展覽與商務媒合活動，提升整體品牌曝光與出口動能

強化目標市場進入準備

- 規劃產品開發、國際認證課程，提升企業技術與合規能力
- 拜訪國際企業及駐臺機構，公私協力累積合作基礎

三、產業聯盟推動情形

已成立

半導體聯盟(2024/7/1)：
服務台美日等國的台積電，
未來進入先進封裝與矽光子
供應鏈
(📍美、日)

大健康聯盟(2025/7/30)：
整合委託開發暨製造服務
與臨床資源，商品化進入
國際高端市場
(📍美)

智慧機械聯盟：(2026/6/30)
從賣設備轉向「設備+服務」，
導入智慧服務解決方案，強
化臺灣智慧機械國際輸出能
力。
(📍日、中東歐)

車用零組件聯盟(2024/7/23)：
開拓美國市場，推動智造升
級，切入軍工與機器人高
端市場鏈
(📍美、德)

數位聯盟(2025/7/2)：
整合 IP/Consulting 服務，
建立跨領域AI創新應用平台
(📍越、泰)

食品聯盟：(2026/6/25)
以「即食化+快速補貨」為
主軸，整合供應鏈、檢測驗
證與通路資源，建立市場合
作模式。
(📍美、日)

籌組中

金屬加工聯盟：(2026/Q3)
因應關稅風險，推動傳產二代接班，
從單一加工躍升為系統供應
(📍美)

三、產業聯盟推動情形—短中長期作法

供應服務鏈切入/產業轉型		整合與AI導入		國際拓展與高值化
聯盟		短期	中期	長期
半導體		輔導聯盟廠商取得國際認證與合格供應商代碼	與海外在地SI系統商建立合作體系	進入先進封裝與矽光子供應鏈，強化關鍵技術定位
車用零組件		以聯盟帶動美國通路布局	整合電商與實體通路	導入創新技術，進入高階市場
數位		建立 IP /pre-sale /sale consulting 完整服務鏈	強化AI整合與應用能力	推動整體解決方案進入東南亞
大健康		串接醫院、藥局與通路商	整合新創技術，開發高值化健康產品	進軍美國等高門檻市場
智慧機械		推動設備智慧化與服務化轉型	建立智慧設備整體解決方案	擴展海外服務據點與國際合作網絡，提升品牌能見度
食品		建立即食食品驗證與出口輔導機制	整合供應鏈、通路與快速補貨模式	拓展國際市場與品牌通路
金屬加工		盤點與開發ODM產品品項	整合電商與實體通路測試市場	推動高值化產品，進入國際品牌通路

三、產業聯盟推動情形

目標市場

半導體

美、日

車用零組件

美國NAPA、Dorman
經銷商車用零組件售
後市場

數位

越南傳統產業台商為主

策略作法

- 產品升級與核心技術研發
- 產品驗證與市場導入

- 企業賦能與聯合開發
- 全球布局與在地化服務

- 越南台商智慧製造 demo site
- 形成可複製案例進行推廣

三、產業聯盟推動情形

大健康

目標市場

短期拓展美國醫療體系市場，中長期尋找美國合作夥伴

策略作法

- 建立CDMO產業協作平台
- 形成國際通路布局

智慧機械

中東歐(捷克、波蘭)、日本代理商

- 提升產品智慧化及服務效率
- 建立共同拓銷機制

食品

北美、日本零售及大賣場市場

- 提升產品出口競爭力
- 建立共同拓銷機制

三、產業聯盟推動情形

目標市場

美國智慧衛浴、節水控制
產品市場

美歐高值化航太、半導體及
無人機市場

策略作法

- 掌握市場需求
- 商品需求測試與市場導入
- 產品分類與市場導入

- 掌握市場需求
- 協助高值化發展及品質把關

金屬加工

五、階段成果與未來執行重點

(一) 階段成果

1. 已成立6個聯盟，共205家業者已加入，搶占美、日、泰、越、德等海外市場
2. 今年6月25日、6月30日新增智慧機械與食品聯盟，Q3結束前成立金屬加工聯盟
3. 已成立半導體2家控股公司，年底前再成立車用及數位聯盟2家控股公司

(二) 未來執行重點

1. 一起接單：籌組海外控股公司，建立共同接單與分工平台，聯合爭取訂單
2. 一起研發生產：整合研發資源發展解決方案，並與海外系統商建立合作體系與生產據點
3. 一起定規則：打造國際產業聯盟品牌，實質參與並主導國際供應鏈規則制定

簡報完畢，敬請指教